

関西最大級のイノベーションの祭典 「国際イノベーション会議Hack Osaka 2023 2nd. Edition」 参加申し込み受付開始！

国際イノベーション会議Hack Osaka実行委員会(構成:大阪市、公益財団法人都市活力研究所、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)大阪本部、公益財団法人大阪産業局)は、2023年12月18日(月)・19日(火)に開催する「国際イノベーション会議Hack Osaka 2023 2nd. Edition ~Accelerating innovation in Osaka ~」の参加申し込み受付を開始しました。

Hack Osakaは、世界のイノベーションの潮流や大阪・関西発のイノベーションの成果を発信する国際会議で、2013年から年に一度開催しています。

11回目を迎える今回は、国内外のスタートアップや投資家による基調講演・トークセッション、グローバル展開を視野に入れている国内スタートアップ6社によるピッチコンテスト“GET IN THE RING OSAKA”、世界21か国の国や地域から応募のあったスタートアップから厳選された11社によるピッチを含むオープンイノベーションセッション“Succeed together in Osaka and beyond”、国内外のスタートアップによる展示会“Startup Showcase”を実施します。

基調講演・トークセッションには、決済ソリューションを提供する世界的に著名なテクノロジー企業、ストライプジャパン株式会社の代表取締役ダニエル・ヘフェルナン氏、核融合分野で世界最先端技術を有する大阪発スタートアップ企業、株式会社EX-Fusionの代表取締役の松尾一輝氏など、様々な方にご登壇いただきます。

参加にあたっては、[申し込みサイト\(Peatix\)](#)よりお申込みください。

【開催概要】

日時: 2023年12月18日(月) 13:00~18:00 ・ 19日(火) 11:00~17:00

会場: ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター(大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館B2F)

観覧: 一般来場可(参加無料)

内容: 基調講演、トークセッション、スタートアップによるピッチ・展示会等

公式サイト: <https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/>

主催: 国際イノベーション会議Hack Osaka実行委員会

(大阪市、公益財団法人都市活力研究所、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)大阪本部、公益財団法人大阪産業局)

協賛: 池田泉州キャピタル株式会社、阪急阪神不動産株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、さくらインターネット株式会社、伊藤忠商事株式会社

特別協賛: 株式会社コングレ

協力: アビームコンサルティング株式会社、株式会社MBSメディアホールディングス、一般財団法人大阪国際経済振興センター(IBPC大阪)、大阪外国企業誘致センター(O-BIC)、Peatix Japan株式会社、フォースタートアップス株式会社、Plug and Play Japan 株式会社、読売新聞社、Reach Reach

後援: 大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム、京都スタートアップ・エコシステム推進協議会、ひょうご神戸スタートアップ・エコシステムコンソーシアム

【参加方法】

[申し込みサイト\(Peatix\)](#)よりお申し込みください。

※なお同会場において、下記のイベントが同時開催予定です。

○12月19日(火)~20日(水)『[イノベーションストリームKANSAI7.0](#)』

うめきた2期地区開発プロジェクト「グラングリーン大阪」でめざすイノベーション創出に向けて主催者の情報発信のほか、本イベントに関わる皆様とともにイノベーション創出機運を高める都市型カンファレンスです。(主催: 一般社団法人うめきた未来イノベーション機構U-FINO)

○12月20日(水)『[WestShip 2023](#)』

西日本に縁が深い日本を代表する変革者が一堂に会するイベントです。西日本から日本を率いるために必要な「地域や経済のあり方」を議論する場として2019年にスタートし、地域におけるコミュニティの枠を超えたつながり創出をめざしています。(主催: 株式会社ユーザーベース NewsPicks Region)

<本件に関するお問合せ先>

国際イノベーション会議Hack Osaka実行委員会事務局(公益財団法人都市活力研究所)

TEL: 06-6359-1322(月曜日から金曜日まで9:30~17:30 (注)土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

E-mail: hackosaka2023_2nd@urban-ii.or.jp

基調講演・トークセッション 登壇者

*敬称略 *登壇者/内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

基調講演・セッション

12/18	株式会社 EX-Fusion 代表取締役 松尾 一輝
12/19	ストライプジャパン株式会社 代表取締役 ダニエル・ヘフェルナン 他

トークセッション

12/18	<p>セッション①</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フォースタートアップス株式会社 アクセラレーション本部 Public Affairs戦略室 室長 泉友詞 ・近畿経済産業局 局長 信谷和重 ・Flora株式会社 CEO クレシェンコ・アンナ 他
	<p>セッション②</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社Stroly 代表取締役 高橋真知 ・サグリ株式会社 代表取締役社長 坪井俊輔 他
12/19	<p>セッション①</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社三菱UFJイノベーション・パートナーズ 戦略投資部副部長 廣田隆介 ・Sozo Ventures シニアディレクター 齊藤健一 ・NordicNinja VC マネージングパートナー 宗原智策 ・一般社団法人Fintech協会 常務理事/ファンズ株式会社 取締役CLO 高尾知達
	<p>セッション②</p> <ul style="list-style-type: none"> ・National University of Singapore, Associate Vice President (Enterprise), Associate Professor, Benjamin Tee ・Woven Capital, Partner, 加藤道子 ・株式会社Zehitomo, Co-Founder & Chairman, フィッシャー・ジョーダン ・Plug and Play Japan 株式会社 Head of Osaka, Director, Energy & Smart Cities, Kathy Liu

GET IN THE RING OSAKA 概要

「GET IN THE RING」とは、2012年から始まったオランダ発のスタートアップピッチ・コンペティション。世界100か国以上で地域大会が行われ、各国のファイナリストが世界大会に招聘されます。そのユニークなピッチスタイルは、ボクシングリング上で1対1のピッチバトルを行う形式です。スライドはなく口頭(英語)のみで繰り広げられるエキサイティングなピッチショーケースです。大阪産業局では日本大会を年に一度実施してきましたが、8回目となる今回はHack Osakaにおいてリアル開催いたします。

日時:2023年12月18日(月)16:00~17:30(予定)



過去開催の様子

日本企業と海外有望スタートアップ企業との協業がどのようなオープンイノベーションを生み出すか、というテーマのもと、トークセッションを実施。また、グリーンテック、ヘルステック、モビリティ、ロボティクス等、様々な分野の海外のスタートアップ企業11社が登壇。その技術を紹介し、日本での協業への期待について語ります。

[AiGENT-TECH \(イスラエル\)](#)

大規模言語モデル(LLM)と物理世界モデル(PWM)を活用し、現実世界を理解しナビゲートできる高度なデジタルエージェントとロボットシステムを開発。複雑なタスクをすべて自律的に遂行することを可能にする。

ロボティクス

[AIRS Medical Inc. \(韓国\)](#)

MRIの撮影時間を最大50%まで短縮しながら画質向上も実現する、映像品質復元AI基盤のソフトウェアを開発。韓国、米国、シンガポール、香港を含むグローバル市場で250以上の顧客を確保、MRI検査量を平均35%増加させている。

ヘルステック
ライフサイエンス

[ChopValue Manufacturing \(カナダ\)](#)

レストラン、ショッピングセンター、空港等から使用済みの割り箸を回収・洗浄・再利用し、高品質なインテリア家具、建材、消費者社向け製品などを製造する。

グリーンテック

[HCS Pharma \(フランス\)](#)

あらゆるタイプの臓器の細胞外マトリックスを忠実に再現することができる、唯一の3D培養システムを開発。細胞治療、再生医療を発展させる。

ヘルステック
ライフサイエンス

[Klar20 GmbH \(ドイツ\)](#)

分子吸着とbidisperseパッキングにより、飲料水から100%マイクロプラスチックを除去する、生化学スマートコーティング技術を開発。フィルター、コーティングはリサイクルが可能。

ヘルステック
ライフサイエンス

[ListenField \(バンコク\)](#)

リモートセンシングやデータサイエンスを活用し、農業の作付けから収穫までの生産性を予測、最適化するプラットフォームを開発。農業経営における不確実性を軽減し、生産性向上を可能にする。

アグリテック

[Neology \(スイス\)](#)

独自のアンモニア分解技術で水素エネルギーを製造するソリューションを開発。車載型の高効率アンモニア分解・水素精製ソリューションによって大型商用車に水素を供給することで、ゼロ・エミッション車を実現する。

脱炭素

[SoundEye \(シンガポール\)](#)

ヘルスケア、高齢者ケア、監視を目的とした、高度な音認識と深度センシング技術を開発。転倒、ベッドの抜け出し、叫び声などの音を分類できる、高度な音認識ソリューションを提供。

ヘルステック
ライフサイエンス

[Touchlab Limited \(英国\)](#)

量子トンネル技術を用いて、ロボット向けの電子皮膚を開発。人間の肌のように繊細な圧力の調整、圧力をかける方向の調整を可能にすることから、これまでロボットでできなかった作業も可能とする。

ヘルステック
ライフサイエンス

[Valkyrie Industries Ltd \(英国\)](#)

VRとハプティクス技術を組み合わせ、仮想の重量を持ち上げたり抵抗を感じることでできるウェアラブル機器を開発。バーチャルウェイトの使用を可能にするプラットフォームを提供する。

ヘルステック
ライフサイエンス

[WiTricity Corporation \(米国\)](#)

MITスピノフチームが開発したワイヤレスEV充電ソリューション。充電の手間を省き、相互運用性のある充電システム設計を提供する。

モビリティ

Startup Showcase等 概要

IoT、AI、AR/VR、ソフトウェア、コンシューマーエレクトロニクス等、様々な技術をもとにした製品・サービス開発に取り組む、今勢いのある企業がブース出展いたします。**国内外のスタートアップが約40社出展**し、各ブースでは、魅力的な製品やサービスのPR、デモが行われます。

日時: 2023年12月18日(月) 13:00~18:00 ・ 19日(火) 11:00~17:00

内容: 1. Startup Showcase (展示会): 出展スタートアップ約40社による展示会

2. Startup Shout-out Stage: 出展スタートアップによるピッチ

3. Speed Dating: 出展スタートアップとVC/CVC、大手企業との個別面談会

※出展者限定

※面談時間: 15分/各面談

詳細および出展企業についてはHack Osaka 2023 2nd. Edition の[ウェブサイト](#)をご確認ください。